

## 同宇新材料(广东)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

(上接A09版)

7、本次发行可能出现的中止情形详见“四、中止发行”。

8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2025年6月27日(T-2日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址cn.chinadaily.com.cn)上的《同宇新材料(广东)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网、中国金融新闻网、中国日报网以及巨潮资讯网上及时公告,敬请投资者留意。

### 释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、同宇新材、公司	指同宇新材料(广东)股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人(主承销商)、兴业证券	指兴业证券股份有限公司
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台
本次发行	指同宇新材料(广东)股份有限公司首次公开发行1,000.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者按市值申购方式直接定价发行1,000.00万人民币普通股(A股)的行为
投资者	指2025年7月1日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限且在2025年6月27日(T-2日)前20个交易日(T-1、T-2)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者,并且符合《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》(2018.12.29号)的规定。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。其中,自然人、机构根据《中国证券登记结算有限责任公司投资者适当性管理实施办法》(2020年修订)等规定已开通创业板市场交易权限《国家法律、法规禁止购买者除外》
T日	指本次网上定价发行申购股票的日期,即2025年7月1日
元	指人民币元

### 一、发行价格

#### (一)发行价格的确定

发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上发行价格为84.00元/股。此价格对应的市盈率为:

- (1) 17.58倍 (每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
- (2) 17.96倍 (每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
- (3) 23.45倍 (每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
- (4) 23.94倍 (每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

#### (二)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

##### 1、与行业市盈率的比较情况

公司主营业务系电子树脂的研发、生产和销售,主要应用于覆铜板生产。公司产品主要包括MDI改性环氧树脂、DOPO改性环氧树脂、高溴环氧树脂、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列。电子树脂、覆铜板和印制电路板,已然成为现代电子产品中不可或缺的重要组成部分,最终被广泛应用于智能家电、工业控制、计算机、消费电子、汽车电子、通讯等各个行业。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2025年6月26日,中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为38.62倍,中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均滚动市盈率为36.03倍。

##### (1)与行业平均静态市盈率比较

本次股票发行价格为84.00元/股,对应的发行人2024年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后静态市盈率为23.94倍,低于2025年6月26日中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率38.62倍。

##### (2)与行业平均滚动市盈率比较

本次股票发行价格为84.00元/股,对应的发行人前四个季

度(2024年4月至2025年3月)扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后滚动市盈率为24.00倍,低于2025年6月26日中证指数有限公司发布的行业最近一个月滚动平均市盈率36.03倍。

##### (3)发行人所属行业变化态势

截至2025年6月26日,C39行业各阶段平均静态市盈率和平均滚动市盈率如下:

行业名称	最近一个月平均静态市盈率	最近三个月平均静态市盈率	最近六个月平均静态市盈率	最近一年平均静态市盈率
C39计算机、通信和其他电子设备制造业	38.62	38.64	40.55	37.91

数据来源:中证指数有限公司。

行业名称	最近一个月平均滚动市盈率	最近三个月平均滚动市盈率	最近六个月平均滚动市盈率	最近一年平均滚动市盈率
C39计算机、通信和其他电子设备制造业	36.03	35.99	37.74	35.52

数据来源:中证指数有限公司。

2024年以来,计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)行业平均市盈率水平较为平稳,本次发行价格84.00元/股对应发行人2024年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为23.94倍,低于中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率38.62倍。本次发行价格84.00元/股对应发行人前四个季度(2024年4月至2025年3月)扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为24.00倍,亦低于中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均滚动市盈率36.03倍,处于合理水平(截至2025年6月26日)。

##### 2、与同行业可比上市公司的比较情况

###### (1)同行业可比公司的选择情况

报告期内,因A股并不存在与公司业务、产品完全一致的上市公司,因此按照业务及产品类别选取同行业可比公司。

东材科技主营业务中的电子材料主要应用于覆铜板领域,其电子材料中的含磷环氧树脂与发行人的DOPO改性环氧树脂具有可比性,其中MDI改性环氧树脂和双酚A酚醛环氧树脂与发行人的MDI改性环氧树脂和BPA型酚醛环氧树脂具有可比性;宏昌电子主营业务中的阻燃型环氧树脂主要应用于覆铜板领域,其阻燃环氧树脂中的无卤环氧树脂与发行人的DOPO改性环氧树脂具有可比性;圣泉集团主营业务中的先进电子材料及电池材料/电子化学品主要应用于覆铜板领域,其先进电子材料及电池材料/电子化学品中的BPA酚醛环氧树脂与发行人的BPA型酚醛环氧树脂具有可比性。上述业务均为发行人的可比业务,故选取东材科技、宏昌电子、圣泉集团作为可比公司。具体情况如下:

公司名称	产品名称	产品特点	产品用途	与发行人产品是否可比	选取理由
圣泉集团	BPA 酚 环氧树脂	1) 环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物; 2) 具有优良的耐热性、耐化学性、耐湿性,以及优良的绝缘性和粘结性	EMC电子封装材料、覆铜板、电子油墨等	是,BPA型酚醛环氧树脂	1) 招股说明书披露的工艺流程与发行人产品类似; 2) 产品特点类似; 3) 产品用途包括覆铜板; 4) 主要客户部分重合
东材科技	含磷 环 氧树脂	无卤阻燃型环氧树脂,固化后具有优良的阻燃性、尺寸稳定性及化学稳定性	应用于覆铜板领域	是,DOPO改性环氧树脂	1) 产品特点(无卤、含磷阻燃)类似; 2) 产品用途相同; 3) 主要客户类似
东材科技	MDI改性环氧树脂	提升材料体系对铜箔的粘接力,提升材料体系的柔韧性和耐热性	应用于覆铜板领域	是,MDI改性环氧树脂	1) 产品特点类似; 2) 产品用途相同
东材科技	双酚A酚醛环氧树脂	1) 环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物; 2) 具有优良的耐热性、耐化学性、耐湿性,以及优良的绝缘性和粘结性	应用于覆铜板生产	是,BPA型酚醛环氧树脂	1) 产品特点与发行人产品类似; 2) 产品用途相同; 3) 主要客户部分重合
宏昌电子	阻燃型环氧树脂(无卤环氧树脂)	酚醛环氧树脂、双酚A、阻燃剂触媒反应,送入溶剂中溶解	应用于电子电气行业,主要用于覆铜板生产	是,DOPO改性环氧树脂	1) 产品特点与发行人产品类似; 2) 产品用途相同; 3) 主要客户部分重合

###### (2)与同行业可比公司的市盈率比较

以2025年6月26日为例,可比公司的静态市盈率情况如下:

证券代码	证券简称	2025年6月26日(T日)前20个交易日均价(前一交易日收盘价孰低值,元/股)	扣非前EPS-TTM(元/股)	扣非后EPS-TTM(元/股)	对应的静态市盈率(前)扣非前	对应的静态市盈率(后)扣非后
601208.SH	东材科技	9.33	0.2019	0.1384	46.21	67.41
603002.SH	宏昌电子	6.01	0.0446	0.0375	134.75	160.27
605589.SH	圣泉集团	27.23	1.0253	0.9803	26.56	27.78
算术平均数(剔除异常值)					26.56	27.78
-	同宇新材	-	3.5826	3.5083	23.45	23.94

数据来源:Wind,数据截至2025年6月26日。

注1:前20个交易日(含当日)均价=前20个交易日(含当日)成交总额÷前20个交易日(含当日)成交量;

注2:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3: 同宇新材总股本按照发行后4,000万股计算,2024年扣非后/后EPS=2024年归属于发行人股东的扣除非经常性损益前/后的净利润÷2025年6月26日总股本;

注4:宏昌电子市盈率显著高于其他可比公司,东材科技2024年业绩大幅下降,故以上可比公司作为极端值及异常值剔除。

以2025年6月26日为例,可比公司的滚动市盈率情况如下:

证券代码	证券简称	2025年6月26日(T日)前20个交易日均价(前一交易日收盘价孰低值,元/股)	扣非前EPS-TTM(元/股)	扣非后EPS-TTM(元/股)	对应的滚动市盈率(前)扣非前	对应的滚动市盈率(后)扣非后
601208.SH	东材科技	9.33	0.2478	0.1820	37.65	51.26
603002.SH	宏昌电子	6.01	0.0398	0.0340	151.01	176.76
605589.SH	圣泉集团	27.23	1.1073	1.0576	24.59	25.75
算术平均数(剔除异常值)					31.12	38.51
-	同宇新材	-	3.5442	3.5000	23.70	24.00

数据来源:Wind,数据截至2025年6月26日。

注1:前20个交易日(含当日)均价=前20个交易日(含当日)成交总额÷前20个交易日(含当日)成交量;

注2:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3: 同宇新材总股本按照发行后4,000万股计算,2024年扣非前/后EPS=2024年归属于发行人股东的扣除非经常性损益前/后的净利润÷2025年6月26日总股本;

注4:宏昌电子市盈率显著高于其他可比公司,东材科技2024年业绩大幅下降,故以上可比公司作为极端值及异常值剔除。

本次股票发行价格84.00元/股对应的发行人2024年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为23.94倍,低于同行业可上市公司对应市盈率算术平均数27.78倍(剔除异常值后,截至2025年6月26日)。

###### 2)与同行业可比上市公司滚动市盈率比较

证券代码	证券简称	2025年6月26日(T日)前20个交易日均价(前一交易日收盘价孰低值,元/股)	扣非前EPS-TTM(元/股)	扣非后EPS-TTM(元/股)	对应的滚动市盈率(前)扣非前	对应的滚动市盈率(后)扣非后
601208.SH	东材科技	9.33	0.2478	0.1820	37.65	51.26
603002.SH	宏昌电子	6.01	0.0398	0.0340	151.01	176.76
605589.SH	圣泉集团	27.23	1.1073	1.0576	24.59	25.75
算术平均数(剔除异常值)					31.12	38.51
-	同宇新材	-	3.5442	3.5000	23.70	24.00

数据来源:Wind,数据截至2025年6月26日。

注1:前20个交易日(含当日)均价=前20个交易日(含当日)成交总额÷前20个交易日(含当日)成交量;

注2:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3: 同宇新材总股本按照发行后4,000万股计算,2024年扣非前/后EPS=2024年归属于发行人股东的扣除非经常性损益前/后的净利润÷2025年6月26日总股本;

注4:宏昌电子作为异常值处理。

本次股票发行价格84.00元/股对应的发行人滚动市盈率(对应的2024年4月至2025年3月归母净利润为扣除非经常性损益前后孰低值摊薄后)为24.00倍,低于同行业可比上市公司对应滚动市盈率算术平均数38.51倍(剔除异常值后,截至2025年6月26日)。

综上,公司考虑自身主营业务、盈利能力、成长性等状况,并结合同行业可比公司业务情况及相关财务数据,在参考了行业市盈率水平和同行业可比公司平均水平后确定本次发行价格,发行市盈率低于行业市盈率水平,低于同行业可比上市公司市盈率水平(剔除异常值),发行定价具备合理性,定价原则

证券代码	证券简称	2025年6月26日(T日)前20个交易日均价(前一交易日收盘价孰低值,元/股)	扣非前EPS-TTM(元/股)	扣非后EPS-TTM(元/股)	对应的滚动市盈率(前)扣非前	对应的滚动市盈率(后)扣非后
601208.SH	东材科技	9.33	0.2478	0.1820	37.65	51.26
603002.SH	宏昌电子	6.01	0.0398	0.0340	151.01	176.76
605589.SH	圣泉集团	27.23	1.1073	1.0576	24.59	25.75
算术平均数(剔除异常值)					31.12	38.51
-	同宇新材	-	3.5442	3.5000	23.70	24.00

数据来源:Wind,数据截至2025年6月26日。

注1:前20个交易日(含当日)均价=前20个交易日(含当日)成交总额÷前20个交易日(含当日)成交量;

注2:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3: 同宇新材总股本按照发行后4,000万股计算,扣非前/后EPS-TTM=2024年4月至2025年3月归属于发行人股东的扣除非经常性损益前/后的净利润÷2025年6月26日总股本;

注4:宏昌电子作为异常值处理。

本次发行价格84.00元/股对应的发行人2024年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为23.94倍,低于招股说明书中所选可比公司2024年扣非前后孰低的归母净利润对应静态市盈率的算术平均数27.78倍(剔除异常值后,截至2025年6月26日);对应发行人滚动市盈率(对应的2024年4月至2025年3月归母净利润为扣除非经常性损益前后孰低值)为24.00倍,低于招股说明书中所选可比公司2024年扣非前后孰低的归母净利润对应滚动市盈率的算术平均数38.51倍(剔除异常值后,截至2025年6月26日)。

###### (3)与同行业可比公司主营业务、产品结构、应用领域、客户群体的比较

公司名称	所属行业	主营业务	主要产品、应用领域	相关客户群体
圣泉集团 605589.SH	化学原料及化学制品制造业(C26)	合成树脂及复合材料、生物材料、新材料产品的研发、生产、销售	主要产品:铸造用树脂、酚醛树脂、电子化学品,包括电子级酚醛树脂、特种环氧树脂等;纤维类、木质素类;应用领域:铸造材料、新能源储能、食品包装、电子产品、生物领域等	电子化学品应用于IC封装、覆铜板生产以及光刻胶、主要客户包括生益科技、建滔集团、南亚新材、华正新材等
东材科技 601208.SH	化学原料及化学制品制造业(C26)	新材料的研发、制造和销售	主要产品:电子绝缘材料、新材料、电子级树脂和环保阻燃树脂等;应用领域:发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源汽车、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电子、复合材料等	电子材料应用于覆铜板生产,主要客户为生益科技等多家知名覆铜板厂商
宏昌电子 603002.SH	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)	电子级环氧树脂、覆铜板、半固化片等;类产品的生产和销售	主要产品:环氧树脂、覆铜板、半固化片等;应用领域:电子电气、涂料、复合材料等	阻燃环氧树脂应用于覆铜板生产,主要客户包括日本松下、生益科技、汕头超声、联茂电子等

###### (4)与同行业可比公司主营业务毛利率的比较

公司与同行业可比公司主营业务毛利率情况比较如下:

公司名称	2024年度	2023年度	2022年度
东材科技	14.12%	19.34%	20.62%
圣泉集团	23.88%	23.16%	20.71%
宏昌电子	5.61%	7.50%	8.69%
平均值	14.54%	16.67%	16.67%
发行人	25.50%	27.91%	24.50%

注:Wind、上市公司披露的定期报告。

与同行业可比公司比较,因产品及应用领域不同,整体上发行人主营业务毛利率高于可比公司。发行人专注于毛利率较高的中高端覆铜板用电子树脂业务。而可比公司业务结构呈现多元化的特点,除经营与发行人具有可比性的电子树脂业务外,亦涵盖其他领域。

###### (5)与同行业可比公司研发投入占比的比较

公司与同行业可比上市公司的研发费用占营业收入比率

的对比情况如下表所示:

公司简称	研发费用率			
	2024年度	2023年度	2022年度	
东材科技	4.30%	5.40%	5.78%	
圣泉集团	5.43%	4.74%	4.76%	
宏昌电子	2.12%	2.03%	1.90%	
行业平均值	3.95%	4.06%	4.15%	
发行人	2.27%	2.17%	1.25%	

数据来源:wind、上市公司披露的定期报告。

报告期内,研发费用率低于同行业可比上市公司平均值,主要系发行人主营业务突出,产品应用领域和主要客户较为集中,研发成果转化率较高,同时产能紧张不具备大规模中试条件所致。

###### (6)与同行业可比公司应收账款周转率等财务指标的比较

报告期内,公司应收账款周转率及存货周转率与可比公司的比较如下:

项目	公司名称	2024年度	2023年度	2022年度
应收账款周转率(次)	东材科技	5.08	4.99	5.38
	圣泉集团	4.83	5.00	5.97
	宏昌电子	3.68	3.40	3.11
	平均值	4.53	4.47	4.82
	发行人	3.99	3.45	4.06
存货周转率(次)	东材科技	7.84	6.20	7.90
	圣泉集团	4.60	4.87	4.52
	宏昌电子	16.15	15.32	13.50
	平均值	9.53	8.80	8.64
	发行人	9.71	12.47	13.89

数据来源:WIND、上市公司披露的定期报告。

报告期内,公司应收账款周转率和存货周转率处于可比公司中间水平。

###### 3、发行人所处行业基本情况

###### (1)电子树脂简介

###### 1)应用于覆铜板生产的电子树脂分类

对于应用于覆铜板生产的电子树脂,从基团类型和化学结构来说,主要包括环氧树脂、酚醛树脂和苯并噁嗪树脂等;从胶液配方组成来说,可以分为树脂和固化剂,二者交联形成的网状立体结构体现出耐热、耐湿等性能。

PCB行业的“无铅无卤化”、线路高密度、薄型化、高速高频等发展趋势,对制作覆铜板基体树脂的耐热、尺寸稳定等性能有了更加严格的要求。一直以来,国内外企业着力于电子树脂的升级研究,特种电子树脂应运而生。

特种电子树脂指的是基于差异化性能需求专门设计的具有特殊的骨架结构和官能团的一系列新型热固性树脂,包括特种骨架结构的环氧树脂、含阻燃特性的酚醛树脂、苯并噁嗪树脂、马来酰亚胺类树脂、聚苯醚树脂等。由特种电子树脂组合制成的覆铜板,其刚性、耐热性、吸水性、线性膨胀系数、尺寸稳定性以及介电性能等指标得以相应改善。

以公司产品MDI改性环氧树脂为例,通过用MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)对基础液态环氧树脂进行改性,在结构中引入特殊的噁唑烷酮杂环结构,有效提升材料与铜箔之间的黏结力,同时固化后玻璃化转变温度明显提高,改善材料耐热性,从而满足高性能覆铜板对基体树脂的使用要求,在计算机、消费电子、汽车等领域得到广泛应用。

###### 2)电子树脂参与覆铜板生产的具体情况

###### A.覆铜板主要生产工艺

###### 玻纤布基覆铜板生产工艺流程图

